

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2014—055

**中材科技股份有限公司**  
**关于申请发行超短期融资券的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券（SCP），以满足公司生产经营与投资的资金需求。

本次发行短期融资券的具体方案如下：

一、发行规模：本次拟注册发行规模不超过人民币30亿元，并在年度贷款预算范围内实施。

二、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

三、发行目的：公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于补充公司及控股子公司的营运资金，偿还、置换银行贷款，补充投资项目建设、研发等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动所需资金等。

四、发行方式：采用持续发行的方式，承销机构余额包销，在全国银行间债券市场公开发行。

五、发行对象：本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场成员。

六、发行利率：公司本次申请发行的超短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

七、发行期限：拟发行的超短期融资券期限为每期不超过270天。

八、公司董事会提请股东大会授权公司董事长薛忠民先生全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行超短期融资券的具体方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

2. 聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报相关事宜。
3. 代表公司进行所有与本次超短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件。
4. 及时履行信息披露义务。
5. 决定并办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。
6. 本授权有效期限自本事项于公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司发行超短期融资券事宜需经中国银行间市场交易商协会批准，尚需提交 2014 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十三日